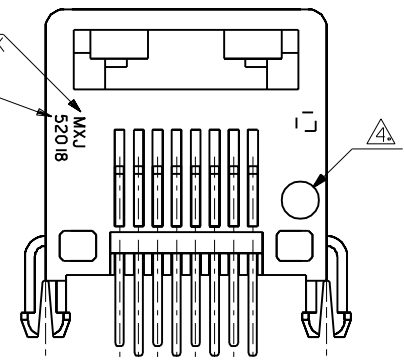
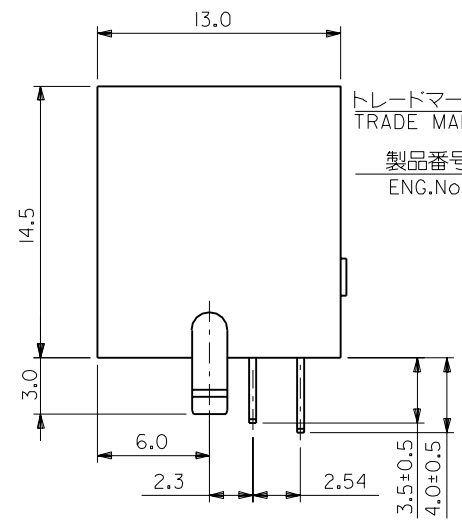
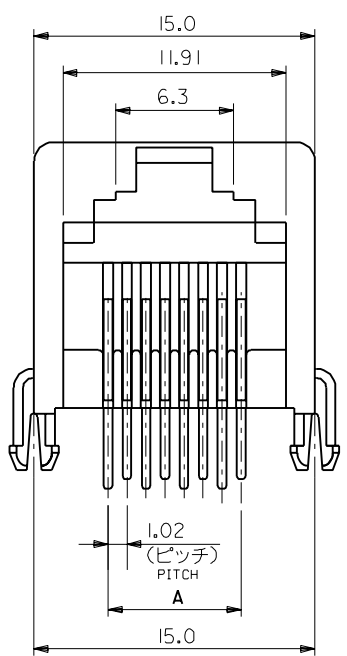
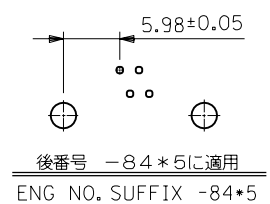
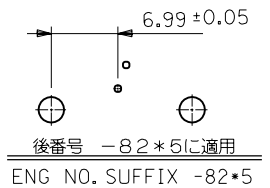
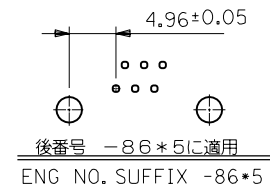
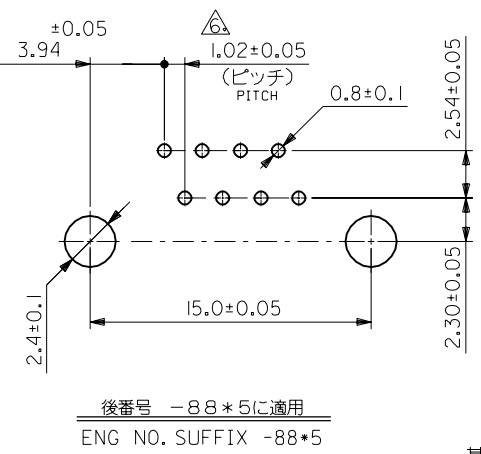


ENG. NO. SD-52018-8**5
EDP NO. —
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



- 注) NOTES
- 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入りポリエステル UL 94V-0
HSG.: POLYESTER G.F.15% UL94V-0
ターミナル: リン青銅
TERM.: PHOSPHOR BRONZE
 - メッキ仕様 PLATING
接点部 : 金メッキ, 表参照
CONTACT AREA: GOLD PER TABLE
半田付け部: 半田メッキ 1.0µmMIN.
SOLDER AREA: TIN-LEAD 1.0µmMIN.
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0µmMIN.
UNDERPLATE: NICKEL 1.0µmMIN.
 - 推奨基板厚: $t=1.6 \pm 0.05$
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: 1.6 ± 0.05
- △ 金メッキ厚標示
COLOR CODING TO INDICATE GOLD PLATING
黄色: 0.1µmMIN. 緑色: 0.38µmMIN.
YELLOW: 0.1µmMIN. GREEN: 0.38µmMIN.
オレンジ色: 0.76µmMIN. 無色: 1.27µmMIN.
ORANGE: 0.76µmMIN. UNMARKED: 1.27µmMIN.
- ハウジングの色は、グレイ。
HOUSING COLOR IS GRAY.
- △ 公差非累積
NON-ACCUMULATIVE



基板穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
(ジャック取付け側)
(JACK ASS'Y SIDE)

8	8	7.11	1.27	52018-8845
			0.76	-8835
			0.38	-8825
			0.1	-8815
	6	5.08	1.27	-8645
4	3.05	1.27	-8445	
2	1.02	1.27	52018-8245	
ポジション POSITION	極数 CIRCUITS	(A)	金メッキ厚(µmMIN.) GOLD PLATING THK(MIN.)	製品番号 ENG. No.

材料 MATERIAL	注参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH	注及び表参照 SEE NOTES AND CHART	EDP. NO.	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—	ENG. NO.	SD-52018-8**5
被覆外径 INS. RANGE	—	TITLE 名称	MODULAR JACK HOUSING ASS'Y
角度 ANGLE	±3°	DRAWN BY '89/10/30	CHK'D BY '96/3/8
30以上 OVER	+0.3	A 変更 REVISED (JC60607)	M.F.H.
10以上 30未満 UNDER	+0.25	O 新規作成 RELEASED (T90386)	M.F.H.
10未満 UNDER	+0.2	記号 LTR 変更内容 REVISION RECORD	DR. 日付 CHK. DATE
一般公差 GENERAL TOLERANCES	REVISION RECORD	APP'D BY '96/3/8	尺度 SCALE 4-1

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

ZF3E110J024J56201808.DGN:1

MXJ-8